



2025年7月3日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ェ ロ ー テ ッ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 賀 賢 漢
(コード番号：6890 東証スタンダード市場)
問 合 わ せ 先 I R ・ 広 報 部 長 野 田 耕 一
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

**当社持分法適用会社（半導体ウエーハ事業）の中国新三板（店頭登録市場）への
登録申請受理に関するお知らせ**

株式会社フェローテック（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、当社の持分法適用会社である杭州中欣晶圆半導体股份有限公司（以下、「CCMC」）が、2025年6月25日に中国における店頭取引市場である中国新三板（全国中小企業株式譲渡システム、以降「新三板」(注)）へ登録申請を行い、この2025年6月30日付けにて受理されましたので、以下の通りお知らせします。

(注) 新三板の内容は添付資料をご参照ください。

記

1. 申請会社の概要（2025年6月30日現在）

(1)	名 称	杭州中欣晶圆半導体股份有限公司 (CCMC)	
(2)	所 在 地	中国浙江省杭州市钱塘新区東壘路 888 号	
(3)	代表者の役職・氏名	法定代表人 賀 賢漢	
(4)	事 業 内 容	半導体ウエーハの製造・販売	
(5)	資 本 金	5,032 百万中国元 (約 1,016 億円) (1 中国元=20.19 円)	
(6)	設 立 年 月 日	2017 年 9 月 28 日	
(7)	当 社 出 資 比 率	23.05%	
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当該会社は当社の持分法適用関連会社です
		人 的 関 係	当社の取締役1名が同社の董事を兼任
		取 引 関 係	該当事項はありません

2. 今後の予定と見通し

当社グループの今期連結業績に与える影響は現時点では軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表いたします。

以 上

<添付資料>

【ご参考】新三板について

<中国証券市場の大まかな構成>

- ・中国の証券市場は大きく主板、新興市場、店頭市場の3つに区分されております。
 - ① 主板(メインボード) : 上海証券取引所、深セン証券取引所等
 - ② 新興市場 : 上海科創板、深圳創業板等
 - ③ 店頭市場 : 新三板、新四板
 - －「新三板」＝正式名「全国中小企業株式譲渡システム」、中国政府がベンチャー育成で後押し。
 - －「新四板」＝正式名「地域制株式市場」、地方金融機関が運営、国内地場市場の位置付け。

<新三板の概要>

- ・新三板は中国国务院(内閣)から認可を得て、証券法に基づいて設立された全国規模の店頭取引プラットフォームのこと。全国中小企業株式譲渡システム有限会社が運営・管理する。
 - －中国証監会が監督し、中国証券業協会が具体的な規則を制定する。
 - －機関投資家及び適格投資家(プロ相当の個人投資家)を対象とする市場である。
 - －発行体の登録条件は上場市場ほど厳しくはないが、ビジネスモデル、経営方針、コーポレートガバナンスなどの観点から、以下の6つの登録条件が定められている。

1)	設立から2年以上経った株式会社であること。 有限会社が株式会社に転換した場合には、存続期間は有限会社の設立日から起算する。
2)	業務が明確で、経営を持続する能力を有すること。
3)	会社のガバナンスが健全で、法を順守した会社経営が行われていること。
4)	株主の権利が明確で、株式の発行・流通が法律に違反していないこと。
5)	スポンサー証券会社の推薦を得て、持続的な監督・指導を受けていること。
6)	全国株式譲渡システム運営会社(運営元)が要求する、その他の条件を満たしていること。

<新三板の区分とCCMC登録区分である「創新層」について>

- ・新三板の市場区分は上から「精選層」「創新層」「基礎層」となっており、今回CCMCは「創新層」登録申請が受理されました。
- ・「創新層」登録は下記いずれかを満たすことが条件であり、CCMCは3)の条件で申請いたしました。

1)	直近2年間の純利益がいずれも黒字であり、累計で800万元以上、または直近1年間の純利益が600万元以上であること。
2)	直近2年間の売上高の平均が3,000万元以上であり、かつ直近1年間の売上高成長率が20%以上であるか、または直近2年間の売上高の平均が5,000万元以上で、営業活動によるキャッシュフローの純額がいずれもプラスであること。
3)	直近1年間の売上高が3,000万元以上であり、直近2年間の研究開発投資の合計が、同期間の売上高の5%以上を占めていること。
4)	直近2年間の研究開発投資の合計が1,000万元以上であり、直近24カ月間または上場と同時の定向増資で、専門機関投資家からの株式投資金額が2,000万元以上であること。

(注) 上記「新三板」関連情報は主として2021年時点の情報であるため、変更されている可能性があります。

【ご参考】CCMC関連開示の履歴(上場および出資に関する事項)

開示日	表題
2024/7/4	当社持分法適用会社(半導体ウエーハ)の上場申請取り下げに関するお知らせ
2022/8/30	半導体ウエーハ持分法適用関連会社による上海証券取引所科創板市場への上場申請に関するお知らせ
2021/10/20	当社持分法適用関連会社(半導体ウエーハ事業)による海通証券(主幹事証券)との上場に関するアドバイザリー契約の締結、および中国証券監督管理委員会による登録受理のお知らせ
2021/9/15	半導体ウエーハ持分法適用関連会社の第三者割当増資(第二回)の払込完了に関するお知らせ
2021/9/15	(開示事項の訂正・変更) 半導体ウエーハ持分法適用関連会社による第三者割当増資(第二回)および設備投資(固定資産の取得)に関するお知らせ
2021/7/15	(開示事項の変更) 半導体ウエーハ持分法適用関連会社による第三者割当増資(第二回)および設備投資(固定資産の取得)に関するお知らせ
2021/6/30	(開示事項の訂正) 半導体ウエーハ持分法適用関連会社の上場に関するお知らせ
2021/6/29	半導体ウエーハ持分法適用関連会社の上場に関するお知らせ
2021/4/15	半導体ウエーハ持分法適用関連会社における第三者割当増資(第二回)、および設備投資(固定資産の取得)に関するお知らせ
2021/2/10	半導体ウエーハ事業子会社の特定子会社の異動に関するお知らせ

2020/11/13	(開示事項の追加・訂正) 半導体ウエーハ子会社の第三者割当増資のお知らせ
2020/11/13	(開示事項の訂正) 半導体シリコンウエーハ子会社の第三者割当増資の払込完了のお知らせ
2020/11/5	(開示事項の訂正) 半導体シリコンウエーハ子会社の株式譲渡代金の払込完了のお知らせ
2020/11/2	(開示事項の経過) 半導体ウエーハ子会社の第三者割当増資の払込完了のお知らせ
2020/10/19	(開示事項の経過) 半導体ウエーハ子会社の株式譲渡代金払込完了のお知らせ
2020/10/16	半導体ウエーハ子会社による第三者割当増資に関するお知らせ
2020/9/17	(開示事項の追加・訂正) 半導体ウエーハ子会社の株式一部譲渡のお知らせ
2020/9/15	半導体ウエーハ子会社の株式一部譲渡のお知らせ

以 上